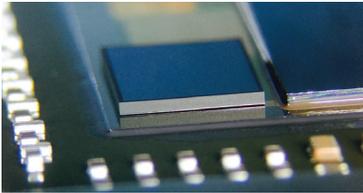


Hohe Produktivität für die fortschrittliche Verpackungsmontage

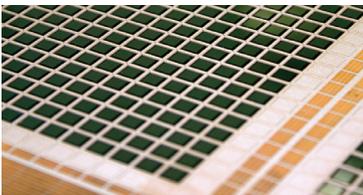
Fortgeschrittene Funktionen für fortgeschrittene Anwendungen:



Komplettes Spektrum an Aktiv- und Passiv-elementen:

Größe: 008004 - 100 x 100 mm

Dicke: 50 µm – 25 mm



Beliebiges Substrat-Format:

Größe: 20 x 20 mm - 813 x 610 mm

Dicke: 50 µm – 12.7 mm



Umfassende Prozessentwicklung

www.uic.com | E-Mail: universal@uic.com

MC-6687B DE

©2019 Universal Instruments Corporation.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben sind freibleibend.

AMERIKA

Tel.: +1-800-432-2607

Tel.: +1-607-779-7522

CHINA, SHENZHEN

Tel.: +86-755-2685-9108

CHINA, SHANGHAI

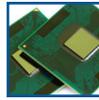
Tel.: +86-21-6495-2100

EUROPA

Tel.: +421-2-4930-96-60

PENANG, MALAYSIA

Tel.: +60-4-644-7067



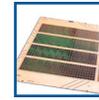
Flip Chip im Paket



System-in-Package



Wafer-Level-Verpackung



Eingebettet



Hochgenaue Stelle



Multi-Die Fan-Out



FUZIONsc.

Halbleiterleistung bei Surface Mount Speeds

Eine Lösung für alle fortgeschrittenen Verpackungsherausforderungen

- Genauigkeit: <10 µm, Geschwindigkeit: 16K cph, Fläche: 813 x 610 mm
- Beliebige Zuführungsmöglichkeit (Wafer, Tray, Tape, Tube, Bulk, Direkt Die)
- Platzieren Sie hochgenaue Aktiv- und Passiv-elemente auf einer Plattform
- Pick-and-Place auf jedem Untergrund, einschließlich dünn/flex
- Advanced Process Lab (APL): Führende Prozess- und Materialkompetenz; Prozessoptimierung, Fehleranalyse

FUZIONSC VIDEO ([hier klicken](#))

